



MSP-40T 形

マグネトロンスパッタ装置

多目的フルオートスパッタリング装置

- この装置は多目的簡易操作型マグネトロンスパッタ成膜装置です。
- 小形卓上型・小スペース装置で、強磁場による多種金属の成膜が可能です。
- 低い電圧でコーティングすると共に試料がフローティング式なので試料損傷を小さく抑えることができます。
- 簡易操作を製品化設計に取り入れ、タッチパネル操作、レシピ機能、シーケンサー制御によるフルオートスパッタ成膜を実現しました。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

TEL.029-212-7600 FAX.029-212-7601

URL : <https://www.shinkuu.co.jp>

E-mail : device@shinkuu.co.jp

装置の仕様

項目	仕様
電源	AC 100V(単相100V15A) アース付き3Pプラグ使用
装置サイズ	幅504mm、奥行486mm、高さ497mm 重量37.7kg
真空排気系	ターボポンプ (TMP) : 67ℓ/sec (装置内蔵チャンバー直結) ダイヤフラムポンプ (DFP) : 16.7ℓ/min (装置外置き・チューブ接続・重量6.5kg)
到達真空度	1×10^{-4} Pa以下
真空度測定	フルレンジ真空計
安全対策	系統別サーキットブレーカ、プログラム制御によるインターロック
操作パネル	タッチパネル式操作ディスプレイ搭載
スパッタ電源	イオン化電流 : 0～640mA イオン化電圧 : 0～650V
タイマー	調整範囲 : 0～9999sec
チャンバーサイズ	内径178mm、深さ159mm ステンレスチャンバー
試料ステージサイズ	直径50mm、アノード電極分離フローティング方式
最大試料サイズ	直径50mm、高さ30mm程度以内
電極—試料台間隔	115mm、95mm、70mm 各試料台付属
ターゲットサイズ	標準ターゲットサイズ : 直径50mm、厚さ3mm) (オプション : 厚さ1mm、2mm対応、厚さ0.5mm貴金属ターゲット+厚さ0.6mmNiプレート)
ターゲット種類	Pt 他貴金属, Mo, Ta, W, ITO, C, Si, Ge, Al, Ni, Fe 等
雰囲気ガス導入	マスフローコントローラによるガス流量自動調整。 アルゴンガス。0.08～0.1MPa。φ1/4インチ接続
ターゲット冷却機構	水冷式ターゲット電極機構。流量スイッチインターロック。 流量1ℓ/min以上。Φ6mmチューブ接続。

必須ユーティリティについて

- 冷却水: 流量1ℓ/min以上 本体配管接続Φ6mmスウェジロック

水道水又は冷却水循環装置(オプション)が別途必要となります。

- アルゴンガス: 95%以上の高純度アルゴンガスをご用意ください。

本体入力ガス圧0.08～0.1MPa、本体配管接続Φ1/4in スウェジロック

※冷却水循環機、Ar ガス、減圧弁、継手、チューブはお客様準備品となります。